

DMS-Rosetten RY51 und XY51

Wichtige Hinweise zur Anwendung von DMS-Rosetten RY51 und XY51

Beim Anlöten der Anschlussdrähte an den gekennzeichneten Stellen ist darauf zu achten, dass die Lötstellen am Rosettenrand nicht erweichen oder schmelzen, da an diesen Stellen die DMS-Anschlüsse zur Leiterplatte durchkontaktiert sind. Lot mit niedriger Schmelztemperatur (<220 °C) verwenden, z.B. 1-LOT-LF Sn95Ag4Cu1. Der Lötspitzendurchmesser soll 0,5...1 mm und die Lötspitzentemperatur nicht mehr als 250...300 °C betragen. Mögliche Flussmittelrückstände unbedingt entfernen, da sie sonst einen Nebenschluss zum DMS-Gitter verursachen können.

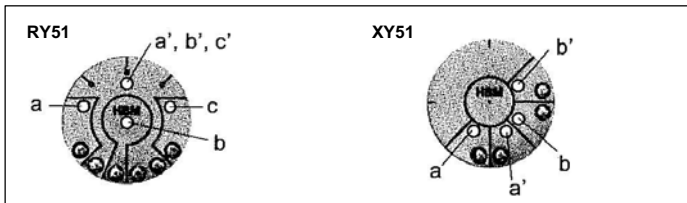
Achtung:
Anschlussleitungen nur an den gekennzeichneten Stellen (0) anlöten, siehe Abbildung, Rosetten möglichst wenig erwärmen.

Strain gauge rosettes RY51 and XY51

Important hints for the use of the strain gauge rosettes RY51 and XY51

When soldering the wires to the solder pads marked one should take care that the solder points at the edge of the rosette do not soften or melt because at these points the strain gauge connections are contacted to the p.c.b. Use solder with low melting point (220 °C), e.g. 1-LOT-LF Sn95Ag4Cu1. The diameter of the solder tip shall be 0.5...1 mm and the temperature at the tip shall be not more than 250...300 °C. Remove any flux residue as these might cause a shunt across the grid of the strain gauge.

Note:
Solder connection cables only to the marked spots (0), see figure. Heat rosette as low as possible.



Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51 · 64201 Darmstadt · Germany

Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany

Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100 · Email: info@hbm.com · www.hbm.com